PCB封装命名规则

目录

[一焊盘命名 3](#_Toc450230813)

[1.1标准表贴焊盘（长方形，正方形，圆形，椭圆形） 3](#_Toc450230814)

[1.2 D形表贴焊盘 3](#_Toc450230815)

[1.3 不规则表贴焊盘 4](#_Toc450230816)

[1.4 通孔焊盘命名 4](#_Toc450230817)

[1.4.1通孔为圆形 4](#_Toc450230818)

[1.4.2通孔为椭圆 4](#_Toc450230819)

[二PCB封装命名 5](#_Toc450230820)

[2.1电容 5](#_Toc450230821)

[2.1.1贴片陶瓷电容 5](#_Toc450230822)

[2.1.2贴片钽电容 5](#_Toc450230823)

[2.1.3贴片电解电容 5](#_Toc450230824)

[2.1.4插件电容 5](#_Toc450230825)

[2.1.5排容 5](#_Toc450230826)

[2.2电阻 6](#_Toc450230827)

[2.2.1普通表贴 6](#_Toc450230828)

[2.2.2排阻 6](#_Toc450230829)

[2.2.3插件电阻 6](#_Toc450230830)

[2.2.4电位器 6](#_Toc450230831)

[2.3电感 6](#_Toc450230832)

[2.4磁珠 7](#_Toc450230833)

[2.5保险丝 7](#_Toc450230834)

[2.6晶振 7](#_Toc450230835)

[2.7二极管/三极管 7](#_Toc450230836)

[2.8连接器 7](#_Toc450230837)

[2.8.1排针命名 7](#_Toc450230838)

[2.8.2排母命名 8](#_Toc450230839)

[2.8.3简牛座 8](#_Toc450230840)

[2.8.4接线端子 8](#_Toc450230841)

[2.8.5 FPC座 8](#_Toc450230842)

[2.8.6专用连接器 8](#_Toc450230843)

[2.8.7 其他连接器 9](#_Toc450230844)

[2.9.芯片 9](#_Toc450230845)

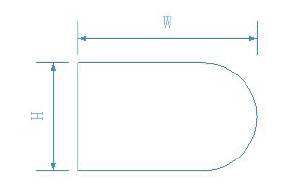
[2.10.其它器件 9](#_Toc450230846)

# 一焊盘命名

## 1.1标准表贴焊盘（长方形，正方形，圆形，椭圆形）

* 长方形焊盘：r宽x长 以MM为单位
* 正方形焊盘：sxx xx表示边长
* 圆形焊盘 ：cxx xx表示焊盘直径
* 椭圆焊盘 ：ob长x宽
* 阻焊增量都增加0.1MM

## 1.2 D形表贴焊盘



* 命名：dWxH

## 1.3 不规则表贴焊盘

* 命名：sh-元件名

## 1.4 通孔焊盘命名

### 1.4.1通孔为圆形

1.4.1.1外形为圆形

* 金属孔：tc通孔大小c阻焊大小p
* 非金属孔: tc通孔大小c阻焊大小np

1.4.1.2外形为正方形

* 金属孔: tc通孔大小s阻焊大小p
* 非金属孔:tc通孔大小s阻焊大小np

1.4.1.3外形为椭圆形

* 金属孔: tc通孔大小b阻焊大小p
* 非金属孔:tc通孔大小b阻焊大小np

### 1.4.2通孔为椭圆

1.4.2.1外形为椭圆

* 金属孔: tb通孔大小b阻焊大小p
* 非金属孔: tb通孔大小b阻焊大小np

1.4.2.2外形为方形：

* 金属孔 tb通孔大小s阻焊大小p
* 非金属孔tb通孔大小s阻焊大小np

# 二PCB封装命名

## 2.1电容

### 2.1.1贴片陶瓷电容

* Cxx xx表示封装大小

例：C0402 C0603 C0805

### 2.1.2贴片钽电容

* CTxx xx表示封装大小

例：CT3216-A、 CT3528-B

### 2.1.3贴片电解电容

* CExx xx表示封装大小

例：CE6X6、CE8X10、CE10X10

### 2.1.4插件电容

* CAPxx-DIP xx表示插孔之间间距或是具体型号

### 2.1.5排容

* CAP位数X封装大小

## 2.2电阻

### 2.2.1普通表贴

* Rxx xx 表示封装大小

例：R0402、R0603、R0805

### 2.2.2排阻

* RES位数x封装大小

例：RES4x0402、RES8x0603

### 2.2.3插件电阻

* RESxx-dip xx表示插孔之间间距或是具体型号

### 2.2.4电位器

* POT-xx xx表示电位器具体型号

## 2.3电感

* 一般电感 ：Lxx xx表示封装大小

例：L0402、L0603、L0805

* 其它电感 ： L长x宽
* 共模电感 ：indcm-xx xx表示型号

## 2.4磁珠

* 一般磁珠：FBxx xx表示封装大小或是具体型号

非标准磁珠：FB长x宽

* 磁珠排：FB位数x封装大小

## 2.5保险丝

* 一般贴片Fxx xx表示封装大小
* 其他类的 FUSE-XX具体型号
* 插件保险丝：Fxx-d xx表示具体型号或是两插孔间距，d表示是插件

## 2.6晶振

* OSxx xx表示封装大小

## 2.7二极管/三极管

2.7.1一般命名按照具体型号手册上面给的来命名

2.7.2发光LED灯命名

* 一般贴片：LEDxx xx表示封装大小 LED0603
* 插件： LEDPxx xx表示型号/pin角间距

2.7.3其它类的二极管命名为：D-XX具体型号

其他类的三极管命名为：

## 2.8连接器

### 2.8.1排针命名：

* Conn单双排x每排位数-2\_00/2\_54/1\_27(间距)-smd/dip(贴片/插件) -ma

### 2.8.2排母命名

* Conn单双排x每排位数-间距-smd/dip-fa

### 2.8.3简牛座

* Box-pin数-间距-smd/dip-180/90

180表示直插，90表示90度弯插

### 2.8.4接线端子

* 3.81mm间距: TP381-单双排x每排位数-180/90-W(带锁)
* 5.08mm间距：TP508-单双排x每排位数-180/90
* 3.5mm间距 ：TP35-单双排x每排位数-180/90

备注：180表示直插，90表示90度弯插

### 2.8.5 FPC座

* FPCxx-间距-h/v xx表示位数 h表示卧贴 v表示立贴

### 2.8.6专用连接器

* USB座：USB-具体型号
* 网口座：RJ45-具体型号
* DSUB座：DSUB位数-FA/MA\ DSUB-具体型号
* HDMI座：HDMI-具体型号
* SD卡座：SD-具体型号
* SIM卡座：SIM-具体型号
* 音频座：Audio-具体型号
* 天线座：Ant-具体型号
* 电源座：DC-具体型号

### 2.8.7 其他连接器

* Conn-具体型号

## 2.9.芯片

芯片命名根据手册上的封装命名，如没有就以此芯片的型号命名

* SOIC 宽体命名：SOICxx-W 有些间距不一样的，要加上间距
* TSSOP 宽体命名：TSSOPxx-W 间距不一样的，加上间距 TSSOPxx-间距-/W
* SOT 3脚用SOT-23 ，5脚 SOT23-5 6脚 SOT23-6
* SOP SOPxx-间距 xx表示PIN脚数
* LQFP LQFPxx-间距 xx表示PIN脚数
* BGA BGAxx-间距 xx表示PIN脚数
* QFN QFNxx-间距 xx表示PIN脚数

## 2.10.其它器件

* 电池：BAT-xx
* 按键：KEY-具体型号
* 开关：SW-具体型号
* 蜂鸣器：Buzzer-具体型号
* 麦克风：MIC-xx
* 芯片插座：DIPxx-间距 xx表示PIN角数
* 测试点：TESTxx-smd/dip xx表示测试点直径多大
* 模块命名：Module-具体型号
* 继电器：Relay-具体型号
* 滤波器：Filter-具体型号
* 整流桥：DIOB-具体型号
* 钻孔：HOLExx-P/NP xx表示孔径大小